



# 高温真空回流焊炉

## SNP-613V



独特的步进搬送，无需轨道及调宽机构，解决传统回流焊轨道变形卡板等问题。采用上部热风下部接触式加热，弥补了全热风热传导率低，及全接触式均热性差的缺点。

无卡掉板

腔内底部保温450℃

密封条更换频率低

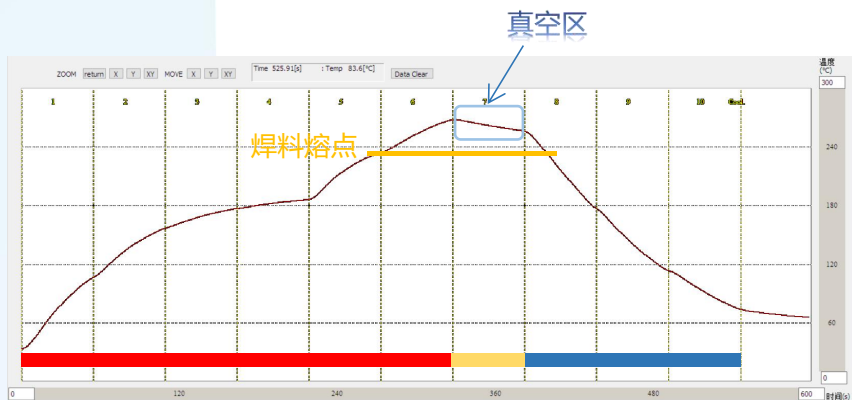
| 应用产品          | 大功率LED       | 功率半导体        | 散热器件         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 氮气<br>氛围焊接    |              |              |              |
| 氮气+真空<br>氛围焊接 |              |              |              |
| 空洞递减率         | 20.6% ➡ 2.8% | 25.7% ➡ 1.6% | 40.3% ➡ 0.8% |

空洞率  
可低至  
1%以下

Precision electronic Scientific cleaning solutions

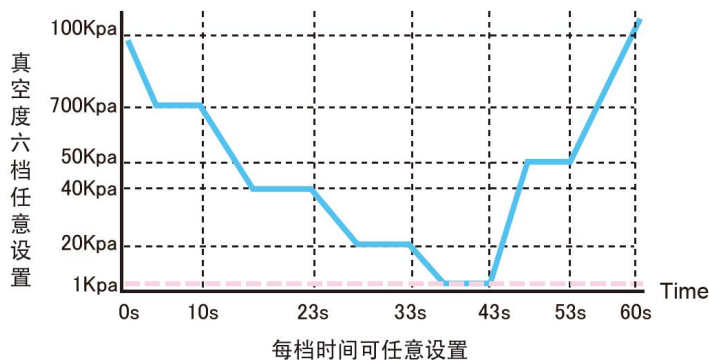


# PRODUCT INTRODUCTION



温度曲线

客户X产品的温度和真空度曲线，仅供参考



真空度曲线

## 高温锡膏对应

上部热风加热弥补了接触式加热所导致的均温性差，以及非金属基板的热传导问题。下部采用高温加热板，最高温度450℃，可以满足金属或陶瓷基板等大热容量功率器件快速升温要求。

## 独特的搬送机构

采用将产品顶起-前移-下降的步进搬送方式，伺服电机驱动以确保移动过程中产品的平稳无震动。没有轨道无需调宽机构，彻底解决传统回流焊轨道变形卡板，调宽卡死的问题。抽真空过程中，产品静置在下部加热板上，对于热传导率高的基板可以达到快速升温的效果。

## 生产成本大大降低

由于炉膛更短，出入口带自动密封门，在同等产能的情况下，比普通真空炉耗电量降低15%以上。

## 规格表

| 型号     | SNP-613V            |
|--------|---------------------|
| 加热区    | 6                   |
| 真空区    | 1                   |
| 冷却区    | 3                   |
| 上部加热温度 | Max 350℃            |
| 下部加热温度 | Max 450℃            |
| 真空度    | 1~10Kpa             |
| 搬送方式   | 两段式伺服托杆             |
| 长      | Max 400mm           |
| 过炉产品 宽 | Max 250mm           |
| 高      | Max 60mm            |
| 搬送面高度  | 900±30mm            |
| 电源     | 3Ø380V、Max48kW、67A  |
| 氮气消耗量  | 18~22m³/h           |
| 生产节拍   | 40~70Sec            |
| 助焊剂回收  | 三段式，附2台焊剂回收装置       |
| 外形尺寸   | L5400*W1250*H1500mm |
| 重量     | 2300Kg              |

实际参数以最终技术规格书为准。2022.01

## 上海仁发商贸有限公司

ADD: 上海市闵行区金都路1199号1号楼112C室

Email: info@srfsh.cn

TEL: +86-21-56309239/+86-186-2158-1273

中国 总部  
info@srfsh.cn

中国 上海  
sales@srfsh.cn

中国 深圳  
dennis@srfsh.cn

中国 大连  
cs@srfsh.cn